(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011 年 6 月 16 日(16.06.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/070739 A1

(51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) *H01L 21/60* (2006.01)
C08G 59/62 (2006.01) *H01L 23/29* (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/006930

(22) 国際出願日: 2010 年 11 月 29 日(29.11.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2009-277461 2009 年 12 月 7 日(07.12.2009) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 **(SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.)** [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 伊藤　慎吾 **(ITOH, Shingo)** [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号　住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 前佛　伸一 **(ZENBUTSU, Shinichi)** [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号　住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 速水　進治 **(HAYAMI, Shinji)**; 〒1410031 東京都品川区西五反田７－９－２　五反田ＴＧビル９階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

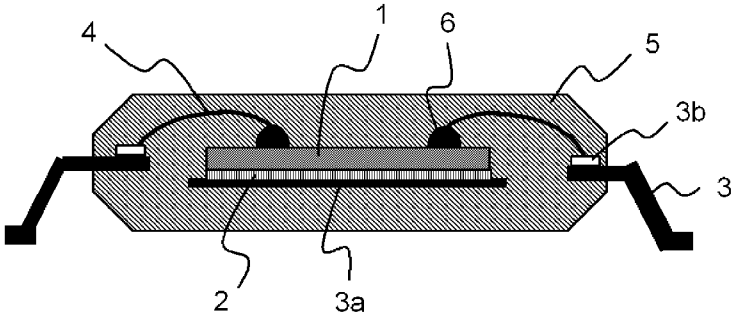
添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

(54) Title: EPOXY RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR ENCAPSULATION, CURED PRODUCT THEREOF, AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING EPOXY RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称 : 半導体封止用エポキシ樹脂組成物、その硬化体及び半導体装置

[図1]



(57) Abstract: Disclosed is an epoxy resin composition for semiconductor encapsulation which contains an epoxy resin (A) and a curing agent (B), and which is used to encapsulate a copper wire (4) and a semiconductor element (1) connected to the copper wire (4). The composition is such that when the cured product thereof is heated for 10 hours at 200°C, a maximum of 70ppm of a first corrosive gas comprising sulfur compounds which have a corrosive effect on the copper wire (4) is generated.

(57) 要約:　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂（Ａ）及び硬化剤（Ｂ）を含み、銅ワイヤ（４）及びこの銅ワイヤ（４）が接続された半導体素子（１）を封止するものである。このエポキシ樹脂組成物は、該エポキシ樹脂組成物の硬化体を２００℃１０時間加熱したとき、銅ワイヤ（４）に対する腐食性を有する硫黄化合物からなる第一の腐食性ガスの発生量が７０ｐｐｍ以下である。

WO 2011/070739 A1